STANDARD LAGENAUFBAU HDI

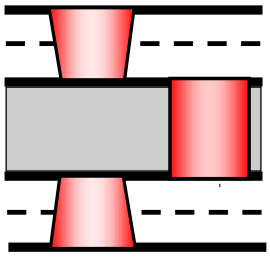
HDI04_1+2b+1_1,15

4 - Lagen

Kern: 0,93 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:		**1 + 2B + 1**
KUNDE:		

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	VSK1			12 µm		35	
			0,930 mm			930	
3	RSK1			12 µm		35	
					1 x 1080	60	
4	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

					Gesamtdicke Material:	1144	

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,15**	+/-	0,09	mm			Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,24	+/-	0,12	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,30	+/-	0,14	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
04.01.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.01.2006	R. Schönholz	00	6+